


ACT

Powered by **半导体科技**
TECHNOLOGY Technology Advanced Packaging CHINA

[首页](#) | [综合话题](#) | [裸晶圆加工](#) | [制造工艺](#) | [封测工艺](#) | [互连](#) | [设备与材料](#) | [芯片设计](#) | [MEMS](#) | [FPD](#) | [Compoundsemi / 光电技术](#)

[注册](#) | [登录](#) | [会员](#) | [标签](#) | [统计](#)

v advertisement v


[半导体科技论坛-myChipChina](#) » [互连](#) » SVTC宣布在300 mm化学机械研磨与Entrepix合作

[« 上一主题](#) | [下一主题 »](#)
[回复](#) [新](#)

SVTC宣布在300 mm化学机械研磨与Entrepix合作

本主题由 Roger 于 2009-2-4 14:17 移动

Roger ▾

发表于 2009-2-4 11:41 只看该作者

小 中


 觉明居士


 发短消息

 加为好友

 当前离线

SVTC宣布在300 mm化学机械研磨与Entrepix合作

SVTC技术公司今天宣布将与Entrepix合作,这项合作将提供SVTC使用德州德克萨斯晶圆厂Tool Access Program (TAP) 户所需的所有300 mm化学机械研磨(CMP)的开发和制造服务.化学机械研磨(CMP)在半导体制造是关键制程步骤。

根据这协议,一切利用SVTC 300 mm Tool Access Program (TAP)的CMP程序处理,技术支持和顾客交接将由Entrepix的工程队在SVTC厂址执行--这外包方式是根据Entrepix在它亚利桑那州坦佩市半导体工厂所采用的方式。

SVTC将外包给Entrepix对其TAP的客户提供CMP核心服务,包括:实验的计划和支助,工程设计方式的监督和资料的分析和报告,并能进行测验性的生产活动。SVTC的Tool Access Program (TAP)则提供厂商使用200套以上的这些工具可以用来完成下列的过程--微影技术(lithography),蚀刻(etch),化学机械研磨(CMP),清洗(cleaning),涂刷(coating)和计量(metrology)。

[« 上一主题](#) | [下一主题 »](#)
[回复](#) [新](#)
[友情连接](#) Our friends

[首页](#) | [关于我们](#) | [联系我们](#) | [收藏本站](#) | [China advertising regulation](#)

ISSN 1814-1579

Copyright © 2008: 《半导体科技》; All Rights Reserved.

备案序号:粤ICP备05082918号

Processed in 0.063163 second(s), 8 queries